

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-115

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、贷款及担保情况概述

根据公司全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司业务发展及资金情况，为满足经营发展需求，促进业务持续稳定发展，惠伦晶体（重庆）科技有限公司拟向银团申请人民币 17,000 万元的贷款，授信期限为 4 年。银团由中国银行重庆綦江支行及农业银行重庆江北支行、南川支行组成，其中，中国银行与农业银行各占 50%。本次银团贷款以惠伦晶体（重庆）科技有限公司所有的渝（2020）万盛区不动产权第 000773039 号地块及土地上厂房（取得不动产权证后）、设备提供抵押担保（达抵押条件后），由公司提供连带责任担保（保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年），专用于高基频超小型频率元器件项目二期建设。

公司董事会授权董事长或其授权人代表公司签署上述贷款额度内与贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、抵押、保证、融资等法律文件。授权期限与银行授信期限一致，在授权期限内，授权额度可以循环使用。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：惠伦晶体（重庆）科技有限公司
- 2、注册资本：20000 万元人民币
- 3、法定代表人：韩巧云
- 4、公司住所：重庆市万盛经开区鱼田堡高新技术产业园
- 5、成立日期：2020 年 6 月 2 日

6、经营范围：电子专用材料研发，物联网技术研发，智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子元器件制造，光电子器件制造，其他电子器件制造，电子元器件与机电组件设备销售，电力电子元器件销售，光电子器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、被担保人与公司的关系：惠伦晶体（重庆）科技有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

8、全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司的主要财务数据（未经审计）为：截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 694,320,352.94 元，负债总额 298,261,268.99 元，净资产 396,059,083.95 元；2021 年 1-9 月，营业收入 3,050,168.33 元，净利润 -4,984,176.06 元。

三、担保的主要内容

为满足惠伦晶体（重庆）科技有限公司业务发展及资金需要，保证高基频超小型频率元器件项目二期建设顺利实施，公司为惠伦晶体（重庆）科技有限公司向银团申请人民币 17,000 万元的贷款提供连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。具体授信额度及担保内容以公司及惠伦晶体（重庆）科技有限公司和银行实际签署的合同为准。

四、审批决策程序

截至本公告日，公司及子公司已签署的融资协议涉及的累计授信金额为人民币 70,040 万元，涉及的累计担保金额为人民币 32,040 万元。鉴于本次银团贷款申请后的累计授信金额将超出 2020 年度股东大会的审批额度（8 亿元），且涉及公司对全资子公司 17,000 万元的担保额使得连续十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，已超出董事会审批权限，故本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司于 2021 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》。

五、董事会意见

董事会认为：全资子公司向银行贷款专用于高基频超小型频率元器件二期项

目建设，公司为全资子公司提供担保，有利于满足公司经营需求，促进业务持续稳定发展，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对全资子公司拥有控制权，能够有效控制和防范风险。

六、独立董事意见

独立董事认为：为全资子公司惠伦晶体（重庆）科技股份有限公司提供担保事项是为支持子公司生产经营活动，属于子公司生产经营和资金使用的合理需要，该担保事项符合公允性原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意本次全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

如上述交易完成后，公司及全资子公司已签署的融资协议涉及的累计授信金额为人民币 87,040 万元，涉及的累计担保为 49,040 万元。公司及全资子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日